



2026/02

# 景美科技 (CMAT)

## 全球信賴的半導體測試介面核心專家

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造

Certain Micro Application Technology  
INVESTOR CONFERENCE

7899.TW

興櫃掛牌：2026年2月25日(半導體類股)

# 免責聲明

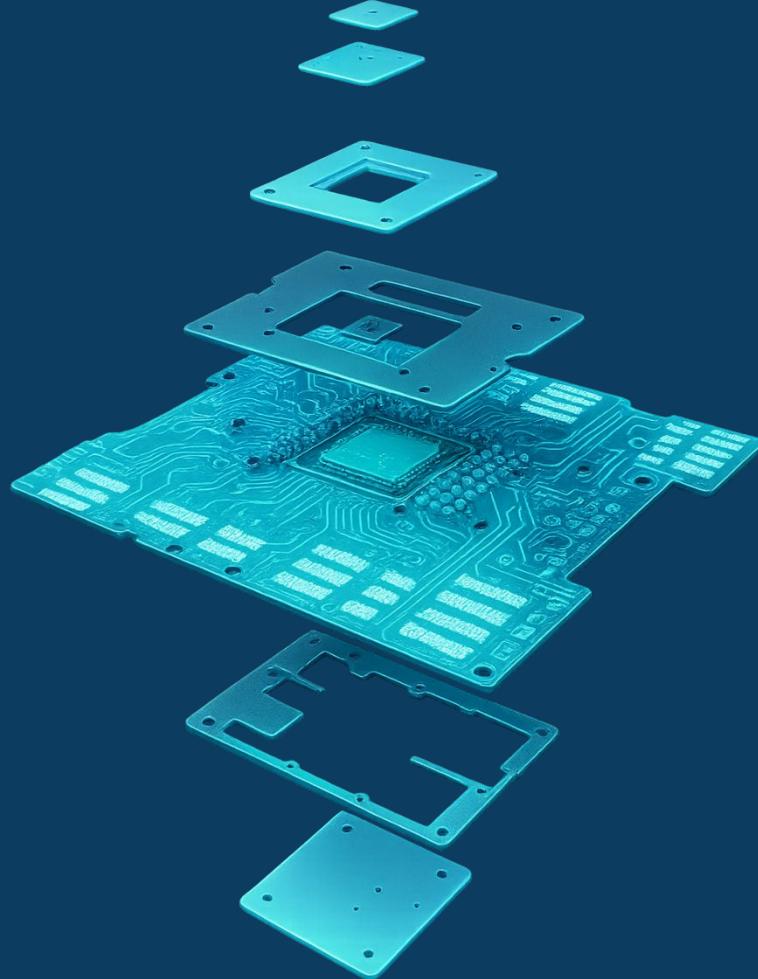


- 除過去資料外，本簡報資料所列事項若為前瞻性看法，可能受重大風險和不確定性因素影響而與實際結果有所差異。
- 本簡報中如有對未來之展望，係反映本公司截至目前為止對於未來之看法，如未來有任何事件或環境變遷，本公司並不負有更新資料之責任。
- 本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明，可能與未來實際結果存有差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 未經本公司許可，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。

7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家  
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

# Content



- 1 公司簡介
- 2 市場觀點
- 3 財務資訊
- 4 投資亮點
- 5 參考資料

**7899.TW**

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



# 公司簡介

01

# 景美科技 二十年深耕，成就不可取代的產業地位



2006

景美科技CMAT公司設立



2007

- 取得ISO認證
- TSMC合格供應商



2013

- 由探針卡供應商轉型為先進製程探針卡結構件供應商



2020

- 取得FormFactor、穎崴、中華精測合格供應商資格



2021

- TSMC ATE Stiffener 驗證通過 (美系測試機)



2023 / 2024

- 取得旺矽合格供應商資格



2025

- TSMC ATE Stiffener 驗證通過 (日系測試機)
- 雷射微鑽孔驗證通過

# 積極擴充產能，以滿足未來先進製程的爆發性需求



## 公司概況與產能擴充計畫

資本額：2.29 億元 董事長：陳吉良 總經理：羅麗文

## 關鍵資訊

營運總部：台灣(土城)

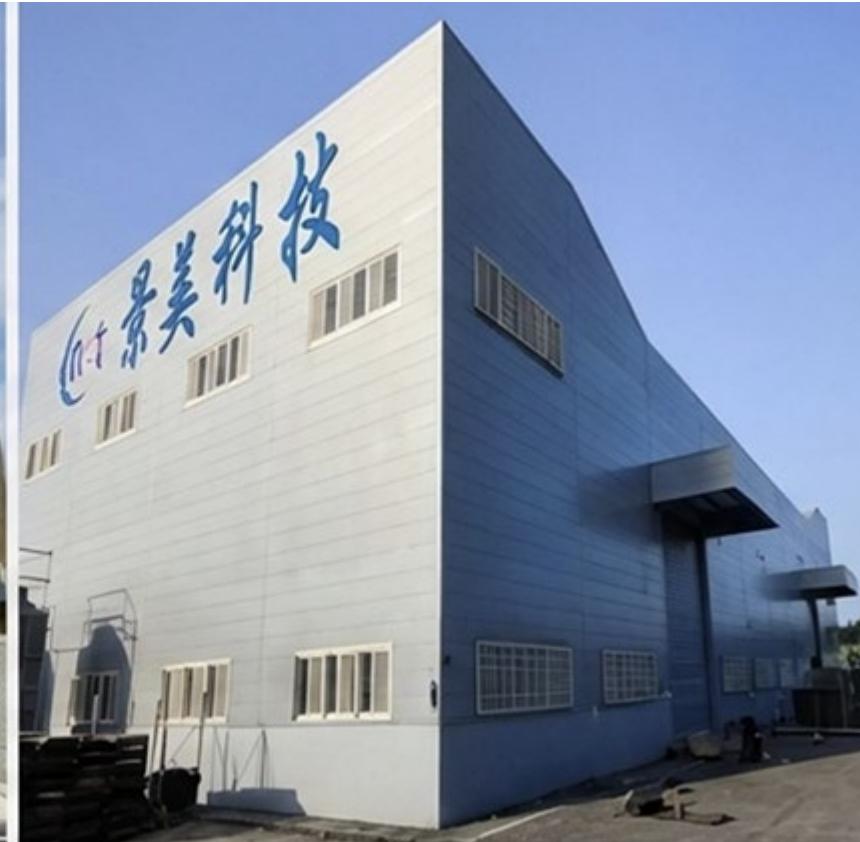
集團員工人數：139人  
(研發人員佔比15%)

## 產能擴充里程碑

宜蘭利澤一廠：已啟用 (2021)

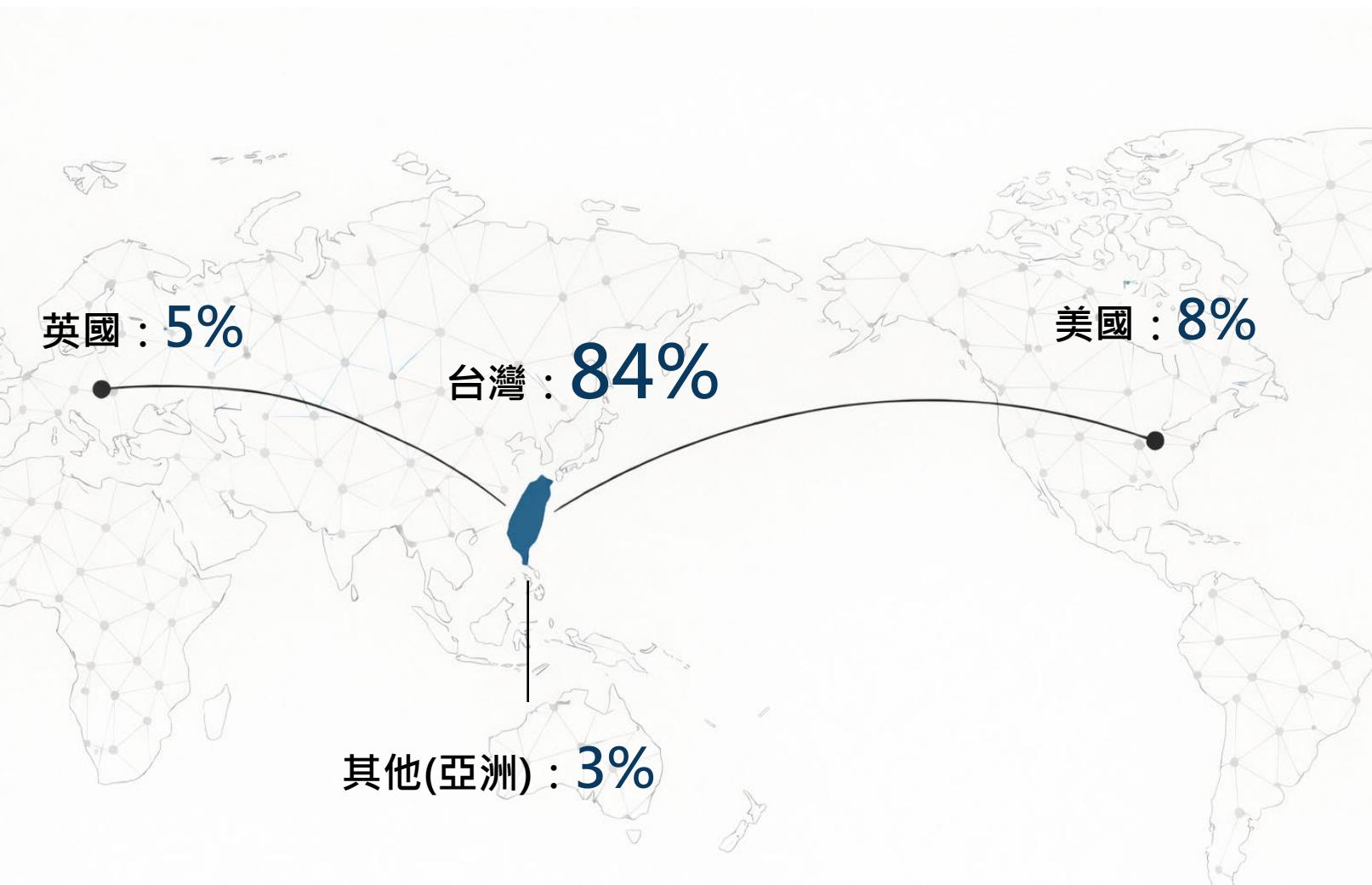
宜蘭利澤二廠：已啟用 (2023)

宜蘭利澤三廠：將啟用 (2028)



擴產計畫是為了因應~未來幾年由AI驅動的市場增長需求

# 立足半導體聚落，服務全球頂尖客戶



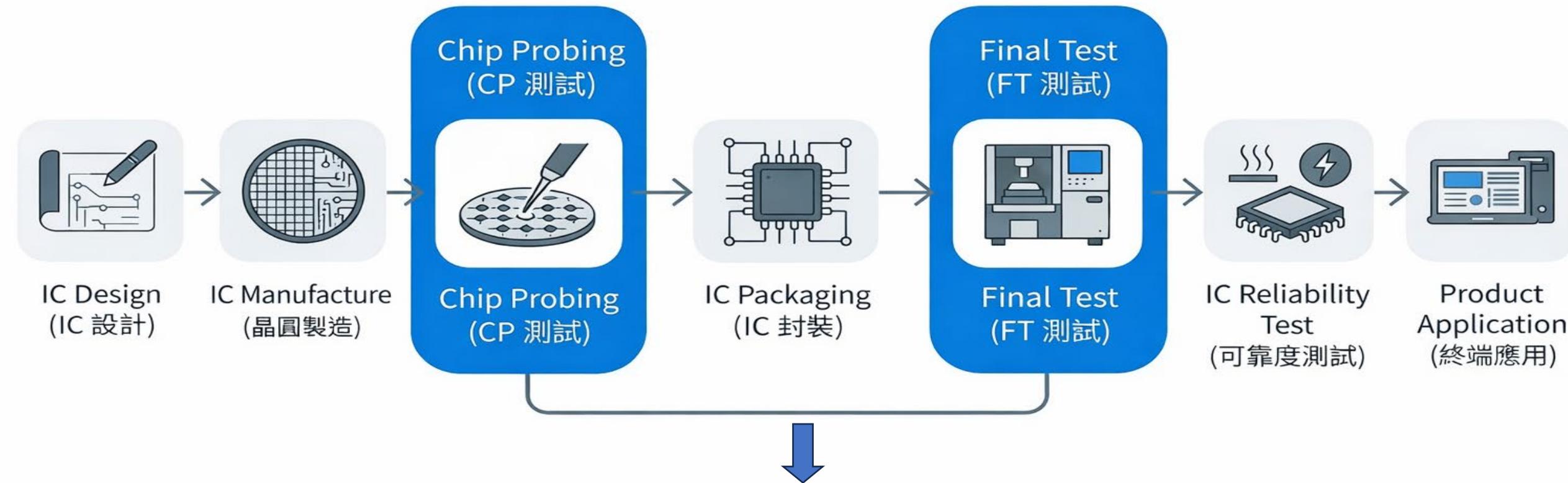
未來五年先進製程產能，  
近八成仍在台灣。



我們的擴產計畫與客戶的發展藍圖緊密結合，確保能就近提供最即時、最深度的服務。

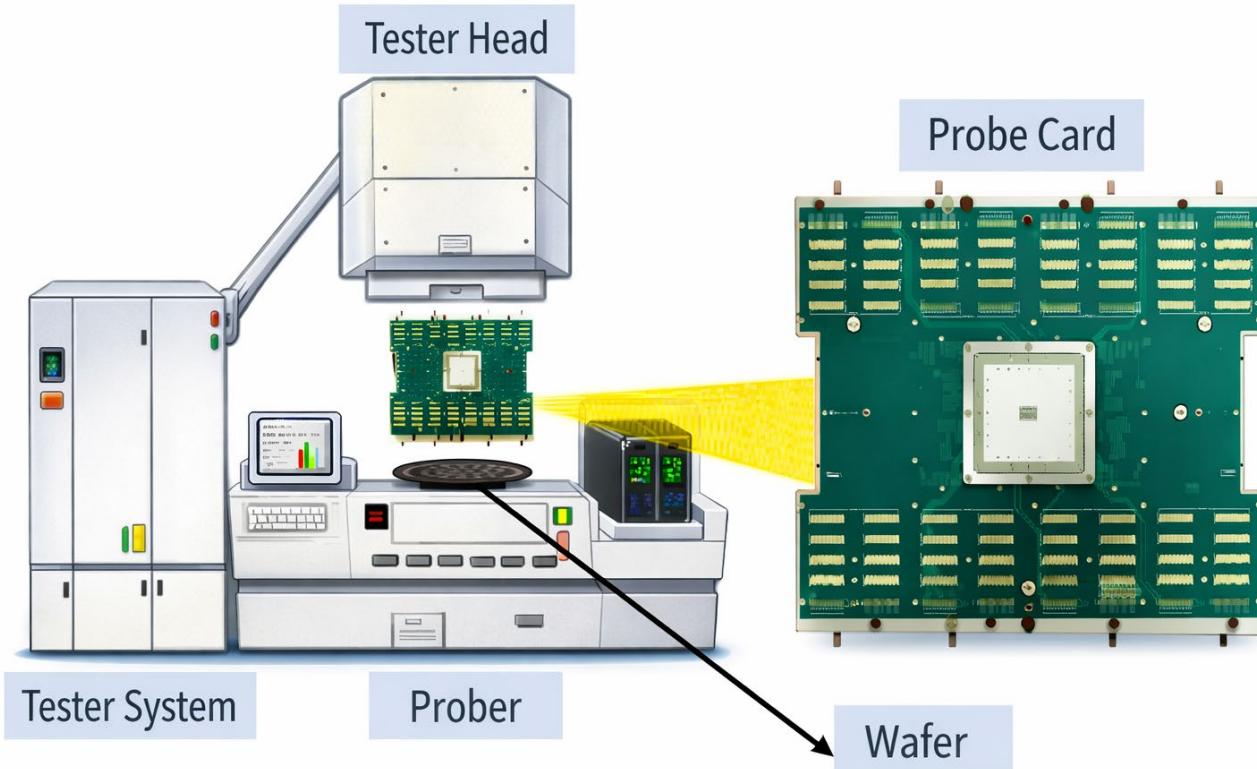
# 景美科技產品 IC 產業鏈之位置

晶圓前段CP 及後段測試FT的關鍵節點



「核心產品：探針卡結構件為關鍵優化節點」

# 為最先進的晶片測試 提供不可或缺的精密基礎



## 核心業務

### 先進製程探針卡-- 結構件設計製造

我們設計和製造探針卡中的關鍵結構件，確保數以萬計的微細探針能夠在微米級的精度下穩定運作。

### 先進製程探針卡-- 微細鑽孔加工

我們的精密鑽孔技術是實現高密度、高頻寬的基礎，對AI和GPU晶片至關重要。

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



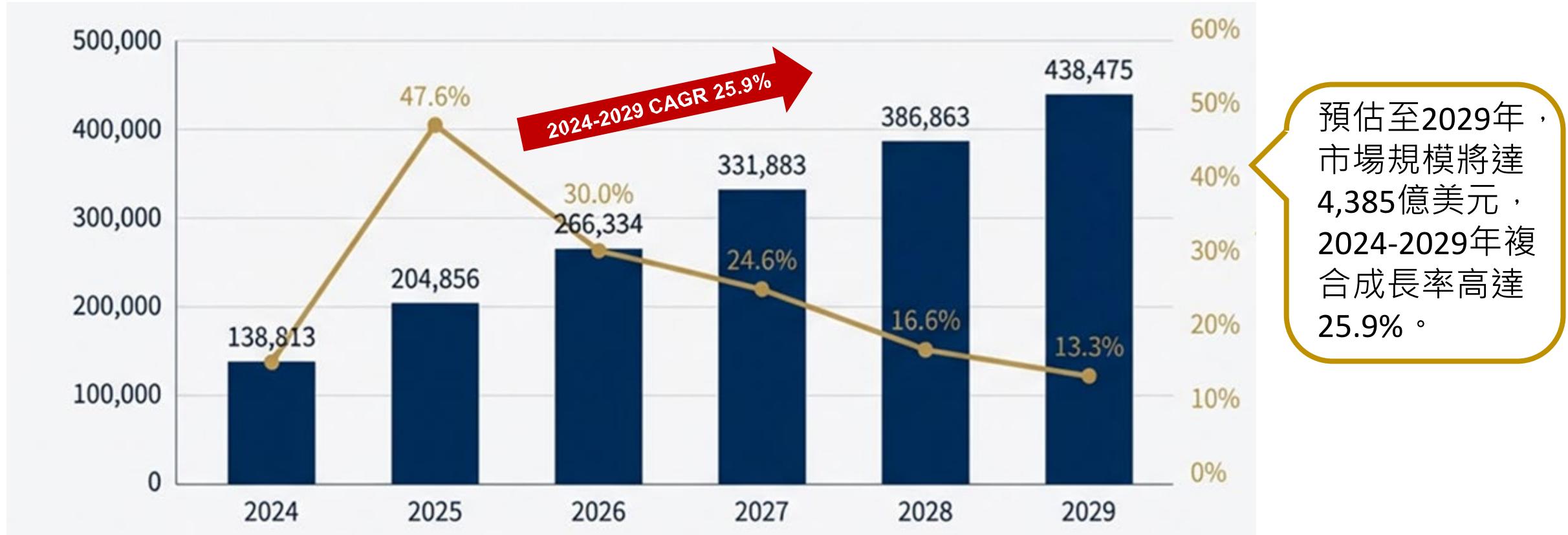
## 市場觀點

02

# AI革命掀起滔天巨浪，半導體需求呈指數級成長

AI應用的爆發性需求是未來五年半導體最關鍵的成長動能。

全球AI半導體市場規模(百萬美元)



# AI應用將是未來五年晶圓代工產業最關鍵成長動能

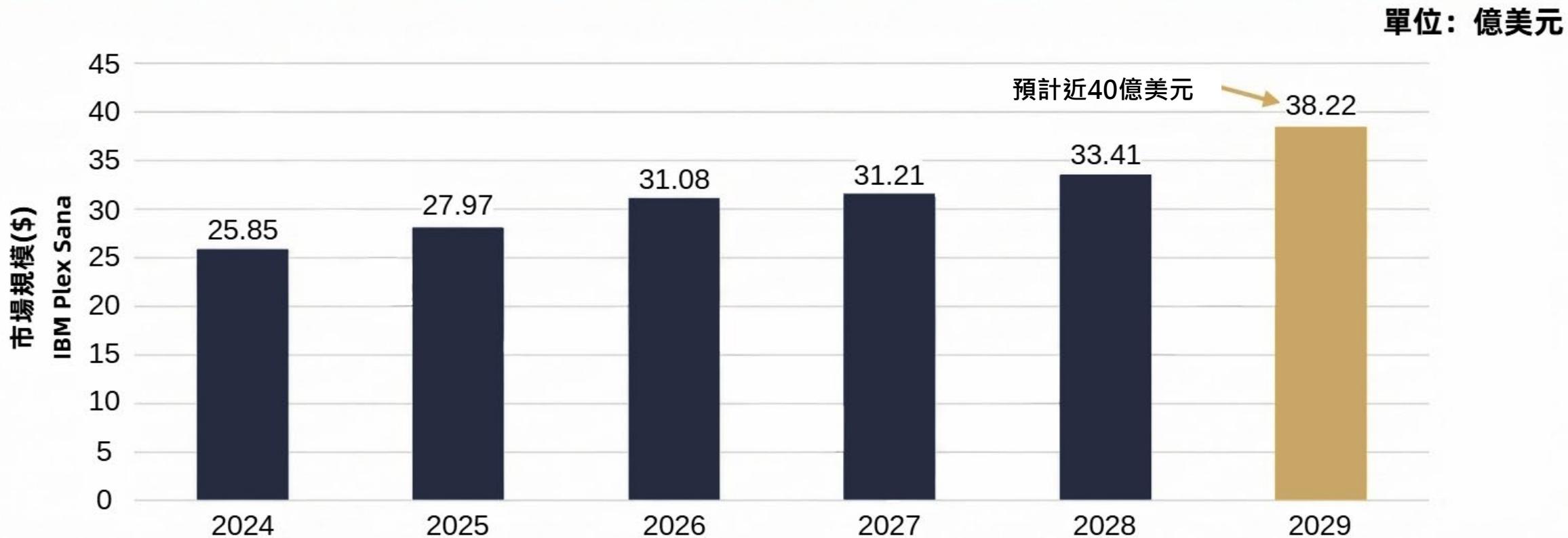
晶圓代工營收影響因素		2025	2026	2027~2030年
需求面	雲端AI應用帶動AI加速器與AI ASIC需求動能。	↑ ★★★	↑ ★★★	↑ ★★
	邊緣AI落地，首波聚焦手機、NB/PC、智慧眼鏡，智慧家庭、工業應用等仍待時間發酵。	↑ ★	↑ ★	↑ ★★
	IDM委外代工需求趨勢穩定。	↑ ★	↑ ★	↑ ★
	地緣政治不確定性干擾晶片需求。	↑ ★	↓ ★	-
	IC載板材料缺貨可能影響部分產品出貨。	↓ ★	↓ ★	-
供給面	5奈米及以下先進製程持續挹注營收成長。	↑ ★★★	↑ ★★★	↑ ★★
	先進封裝技術滿足客戶高階AI晶片需求。	↑ ★★	↑ ★★	↑ ★
	中國半導體自主化發展，成熟製程產能續開出。	↑ ★	↑ ★	↑ ★★
	美國續執行半導體出口管制，抑制中國先進製程供給。	↓ ★	↓ ★	↓ ★

註：影響該年營收程度，↑表示有正向影響，↓表示有負向影響，★越多表示影響性越大，-表示無影響或待觀察。

資料來源：DIGITIMES，2025/11

# 全球半導體探針卡規模 預計2029年增長至近40億美元

複合年增長率顯示強勁動能，顯示TechInsights 與Yole市場共識數據



Noto Sans TC	2024	2025	2026	2027	2028	2029
市場規模平均值	\$25.85	\$27.97	\$31.08	\$31.21	\$33.41	\$38.22
年增長率	22.92%	8.18%	11.12%	0.41%	7.05%	14.42%

全球半導體市場走勢的樂觀預期合理預計全球探針卡市場規模未來3-5年仍將呈快速發展趨勢

資料來源：TechInsights, Yole (2024-2029 Forecast).

# 2024 年度全球半導體前十大探針卡廠商市場佔有率

TechInsights : 2024 年度			
排名	廠商名稱	國家/地區	市占率
1	FormFactor	美國	23.58%
2	Technoprobe	義大利	22.22%
3	MJC	日本	13.33%
4	旺矽科技	臺灣	7.38%
5	JEM	日本	4.74%
6	強一股份	中國大陸	3.25%
7	Nidec SV Probe Pte. Ltd.	新加坡	2.81%
8	Korea Instrument CO., Ltd.	韓國	2.47%
9	TSE CO., Ltd.	韓國	2.16%
10	思達科技股份有限公司	臺灣	1.93%
合計	-	-	83.86%

Yole : 2024 年度			
	廠商名稱	國家/地區	市占率
	FormFactor	美國	24.90%
	Technoprobe	義大利	16.31%
	MJC	日本	13.87%
	旺矽科技	臺灣	7.74%
	JEM	日本	4.93%
	強一股份	中國大陸	3.42%
	Korea Instrument CO., Ltd.	韓國	2.77%
	TSE CO., Ltd.	韓國	2.24%
	思達科技股份有限公司	臺灣	2.11%
	Nidec SV Probe Pte. Ltd.	新加坡	2.03%
	-	-	80.30%

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

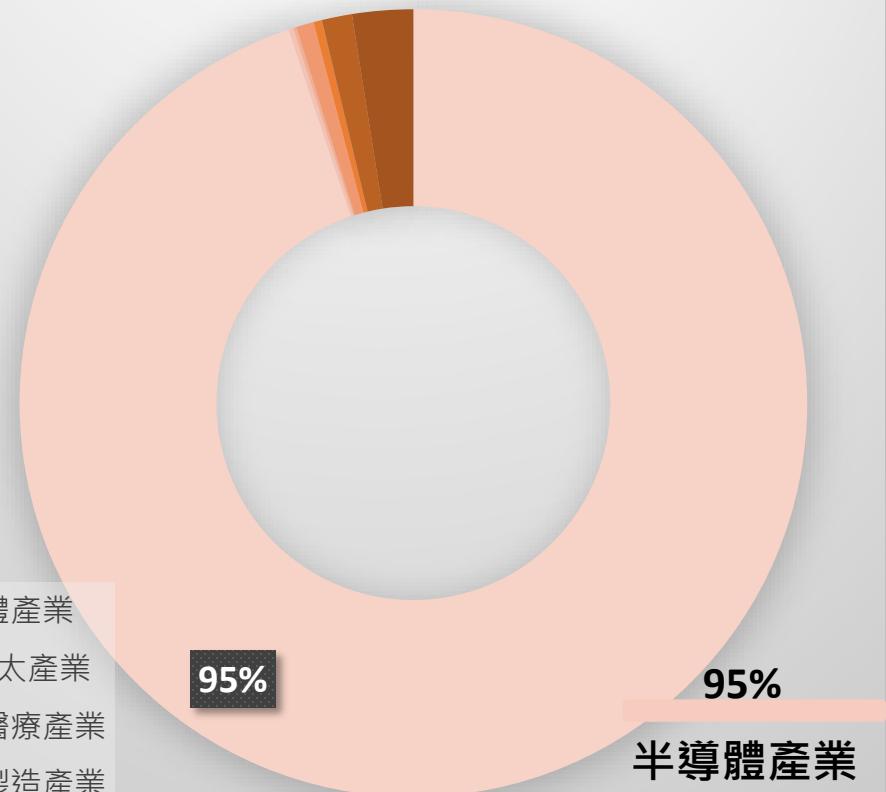
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



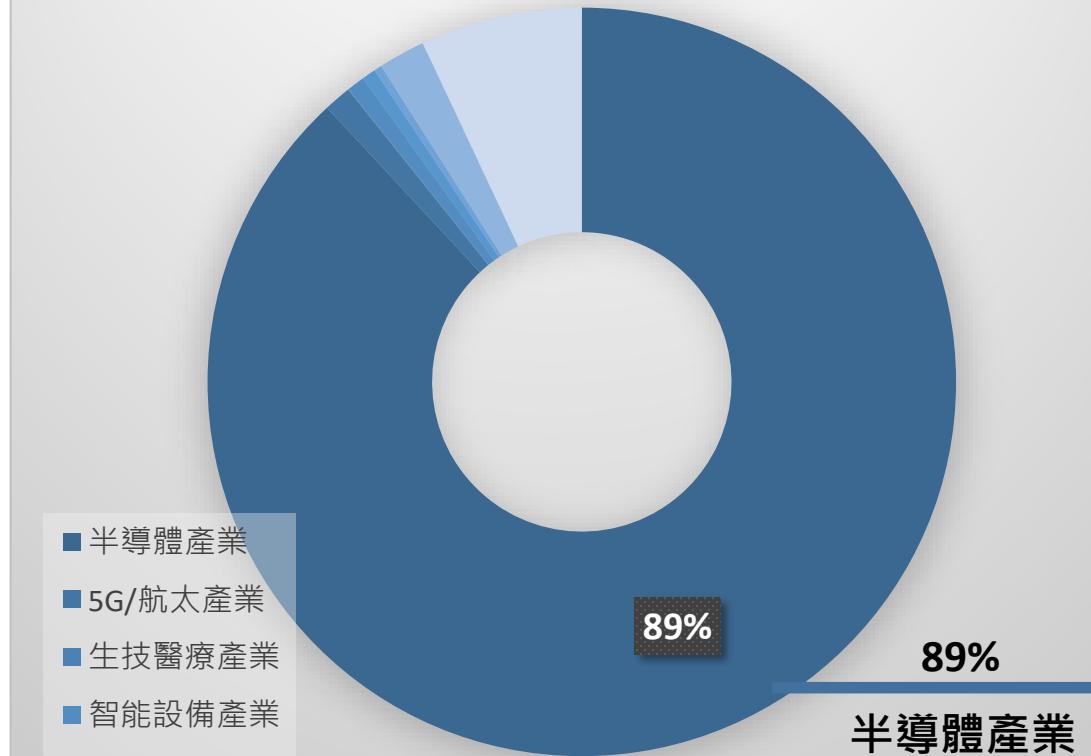
## 財務資訊

03

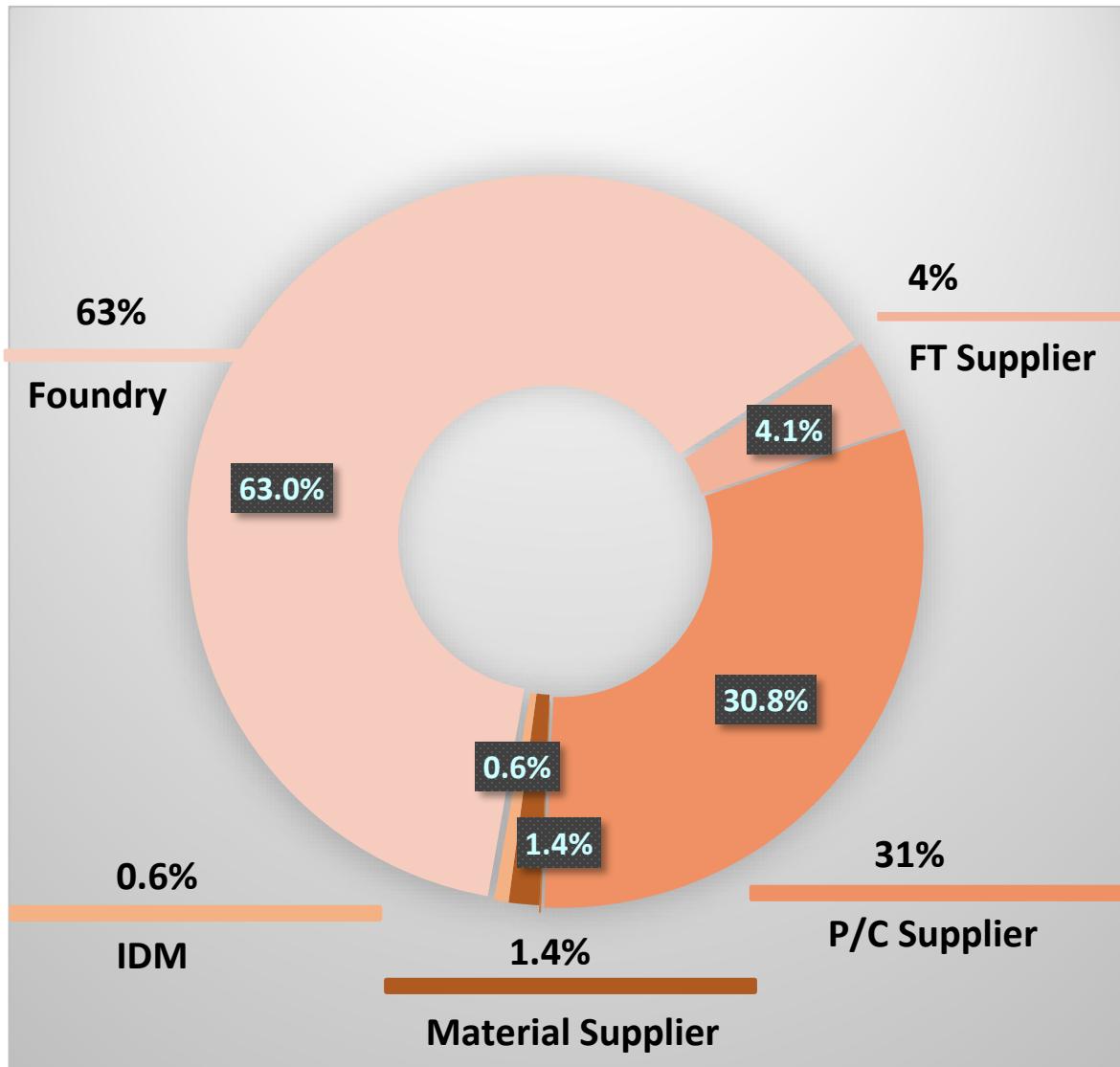
## 2024 客戶產業別占比



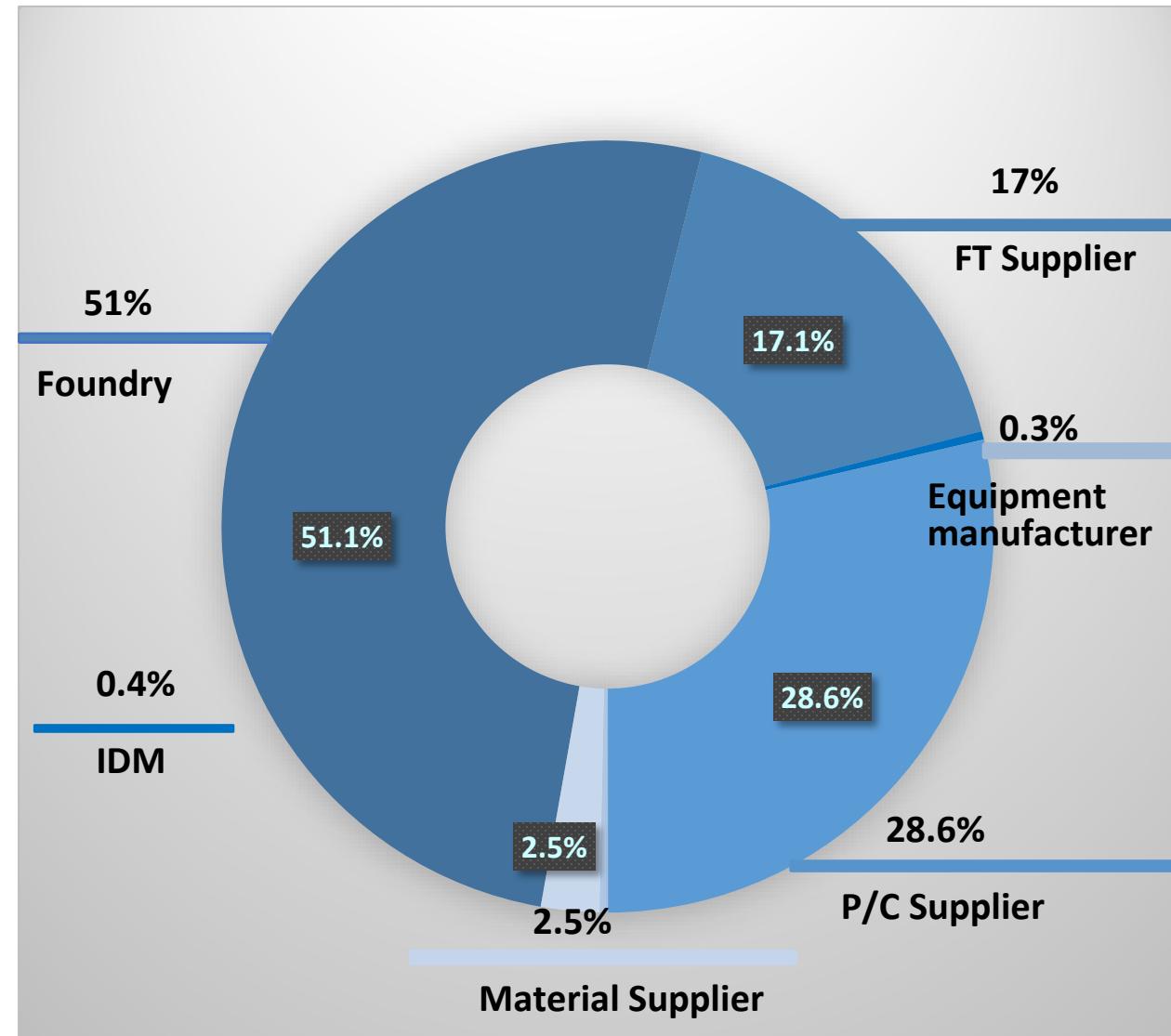
## 2025 客戶產業別占比



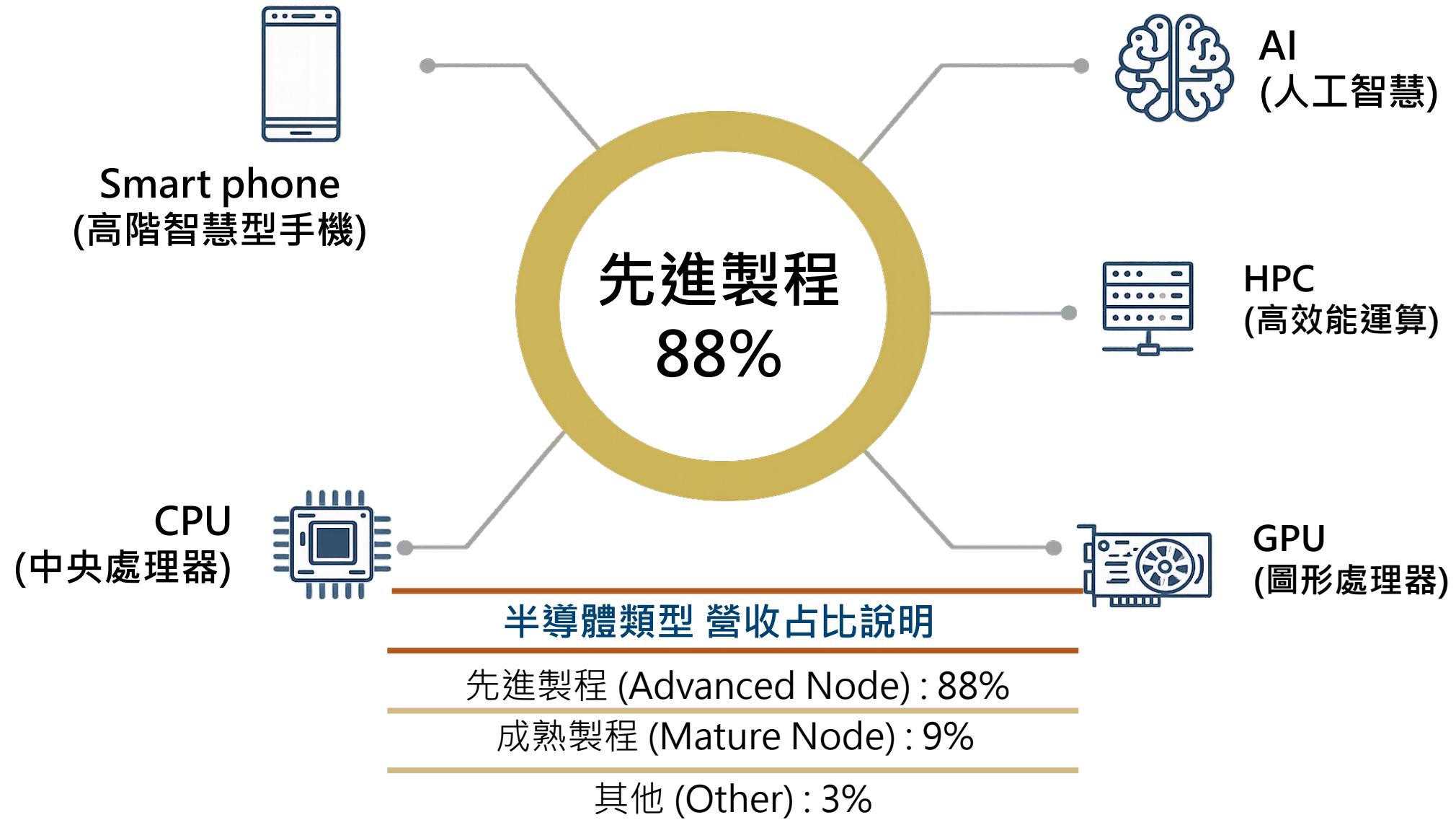
## 2024年 營收95% 半導體客戶類型



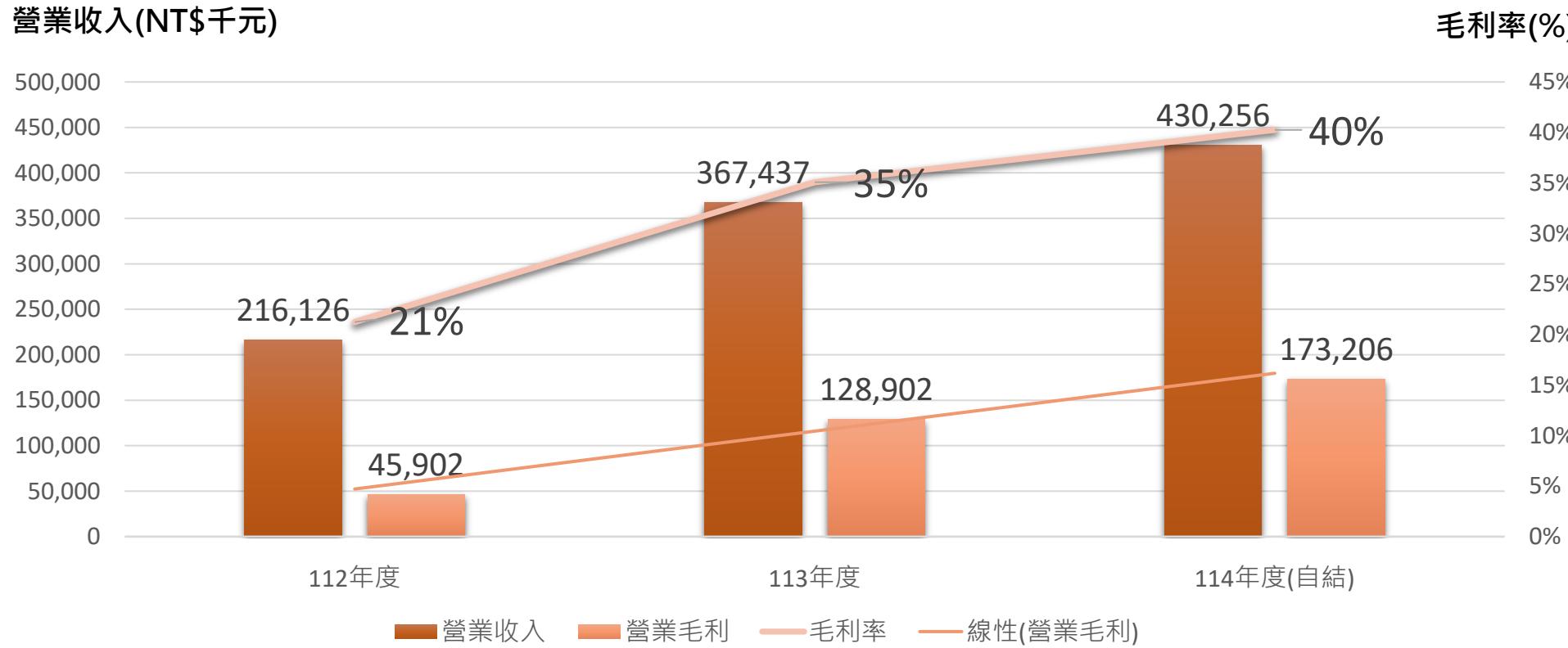
## 2025年 營收89% 半導體客戶類型



# 營收高度集中於先進製程，直接受惠於AI與HPC的強進需求



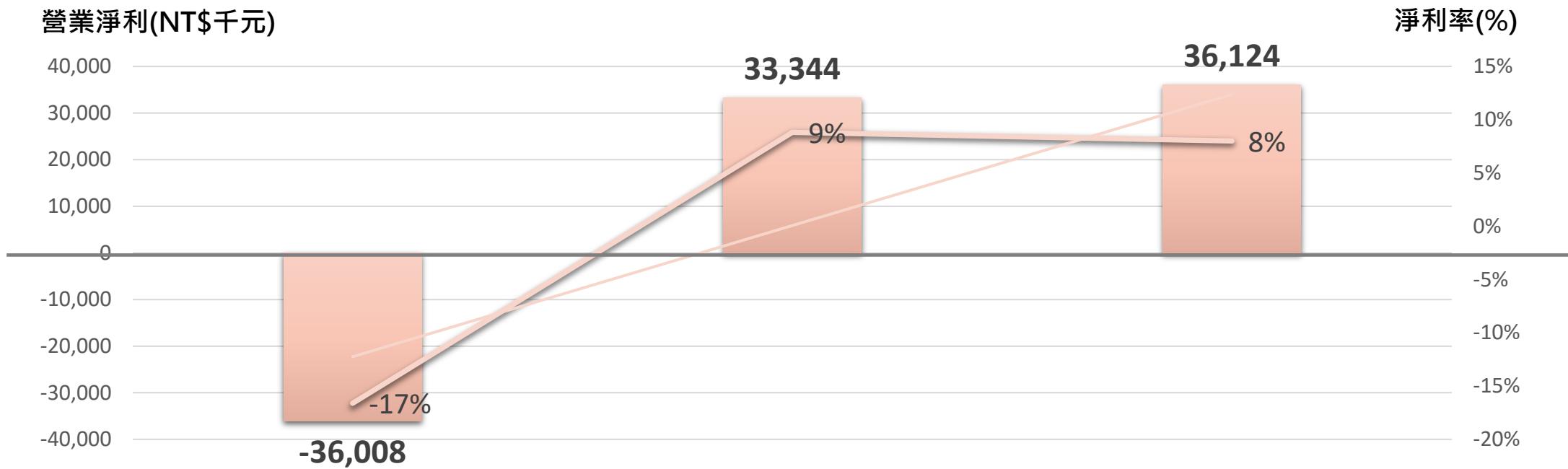
# 合作深化帶動營收成長 高附加價值推升毛利率



(單位: 新台幣仟元)	112年度	113年度	114年度(自結)
營業收入	216,126	367,437	430,256
營業毛利	45,902	128,902	173,206
毛利率	21%	35%	40%

「營收與毛利結構同步增長，展現強勁成長趨勢」

# 規模經濟與營運效率提升 實現淨利率由負轉正的顯著改善



(單位: 新台幣仟元)	112年度	113年度	114年度(自結)
營業淨利	(36,008)	33,344	36,124
淨利率	(17%)	9%	8%

「公司已進入穩定獲利軌道，未來獲利能力具備持續上升空間」

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



## 投資亮點

04

# 共創價值的成長飛輪



## 深度整合夥伴關係

- 研發服務：設計建議與協作 與 痛點解決方案
- 製造銷售服務：穩固訂單且維持長期的上、下游合作關係。

## 驅動多面向成長需求

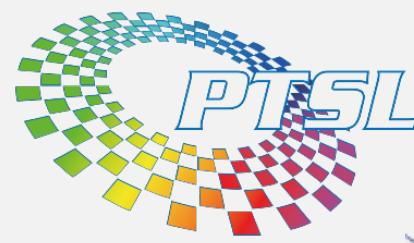
- 設計資源需求
- 產能需求
- 檢驗需求
- 專業夥伴的需求

## 實現共贏的商業價值

- 持續增加的NRE 及 組裝服務收入
- 持續成長的銷貨收入
- 其他設備及維修支援收入

「站在巨人的肩膀上，共創價值」

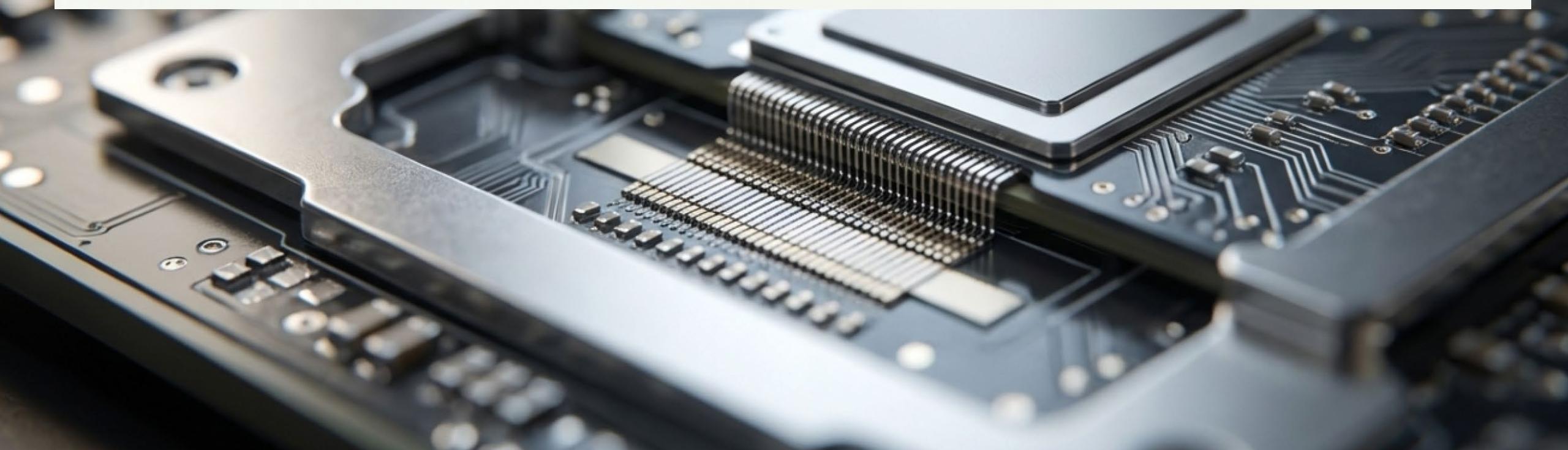
巨人們背後，有一群通過嚴苛考驗的頂尖夥伴



我們的技術，是業界巨擘創新里程的關鍵拼圖。

# 信賴，源自對技術與品質的絕對堅持。

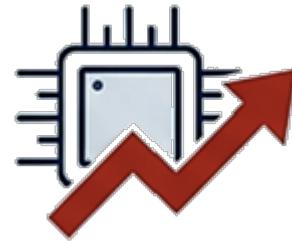
在這個要求零失誤的產業，信任無法輕易獲得。全球領導者的共同選擇CMAT，是因為我們的技術能力滿足最嚴苛的規格，我們的品質承諾確保了最穩定的表現。這不僅是合作，更是我們對核心能力的認可。



# 景美科技(CMAT): 長期價值的四大基石



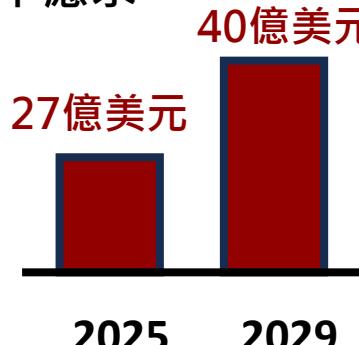
掌握先進製程關鍵，AI浪潮下的隱形冠軍



## 市場潛力

### AI 與 HPC 強勁驅動

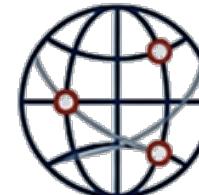
- 我們的技術是先進製程測試不可或缺的一環，直接受惠於AI蓬勃發展，市場供不應求。



## 技術護城河

### 研發製造一體

- 獲巨人客戶高度信賴，品質與交期穩定
- 建構不可輕易取代的產業門檻，驅動中長期成長動能



## 全球布局

### 探針卡廠最強後盾

- 以夥伴思維深度嵌入供應鏈，是客戶可信賴的製造延伸與技術後盾。
- 與台灣、美、英、日、韓探針卡大廠建立深度合作。



## 營運績效

### 獲利體質強健

40%  
毛利率顯著提升

78%  
先進製程產品營收占比

2028年啟用第三座廠區，產能再升級

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

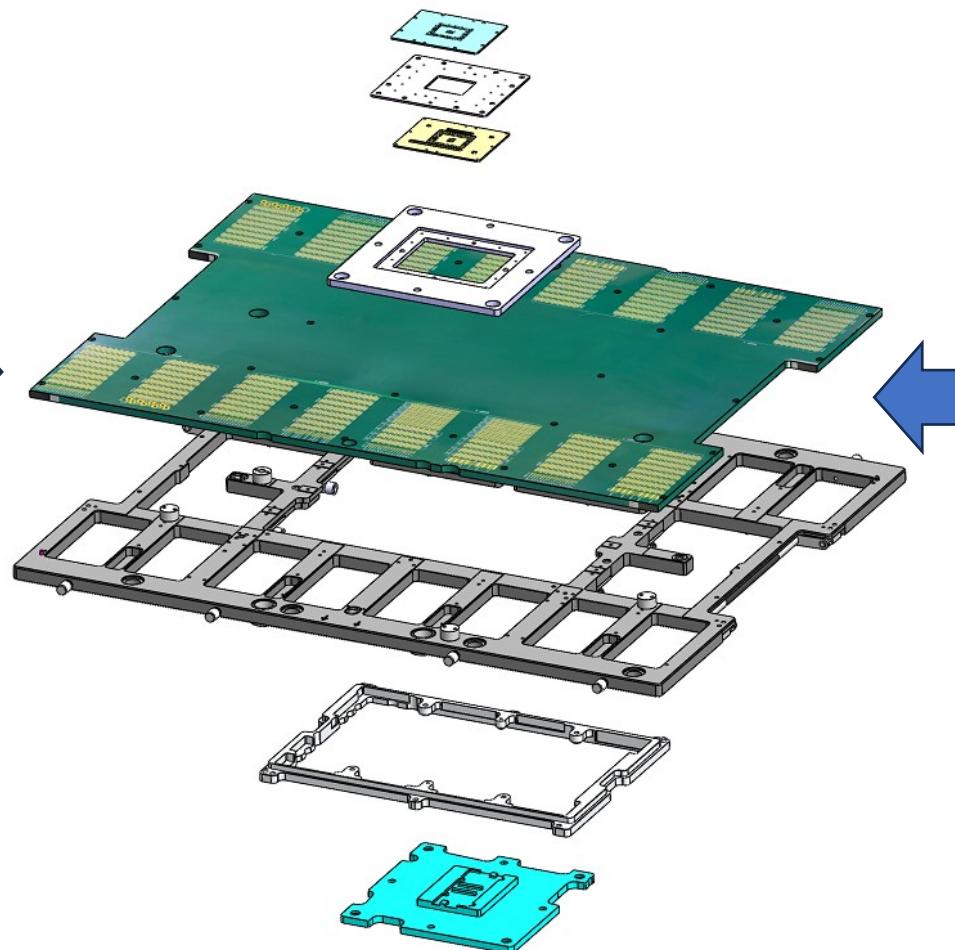
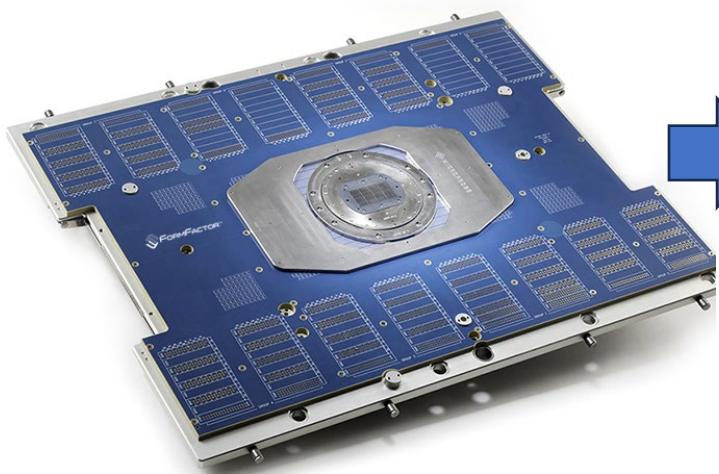


## 參考資料

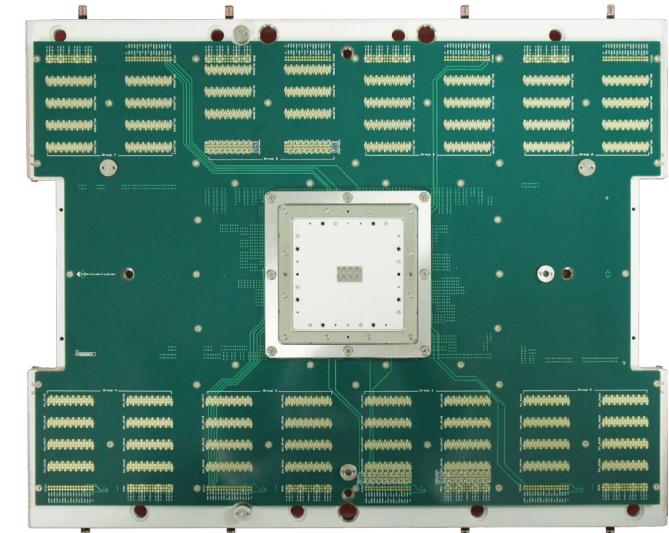
05

# 垂直式探針卡VPC

晶圓測試垂直探針卡 (VPC)  
MEMS Probe



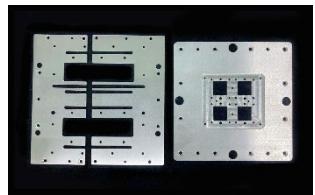
晶圓測試垂直探針卡 (VPC)  
Cobra Probe



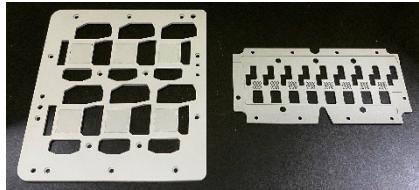
# 垂直式探針卡架構圖 (MEMS/Cobra)

m@t

間隔件 (SUS420)  
Spacer



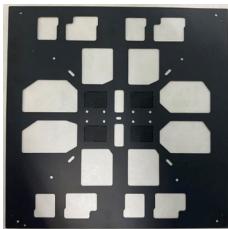
陶瓷微鑽孔  
LD (Lower Die)



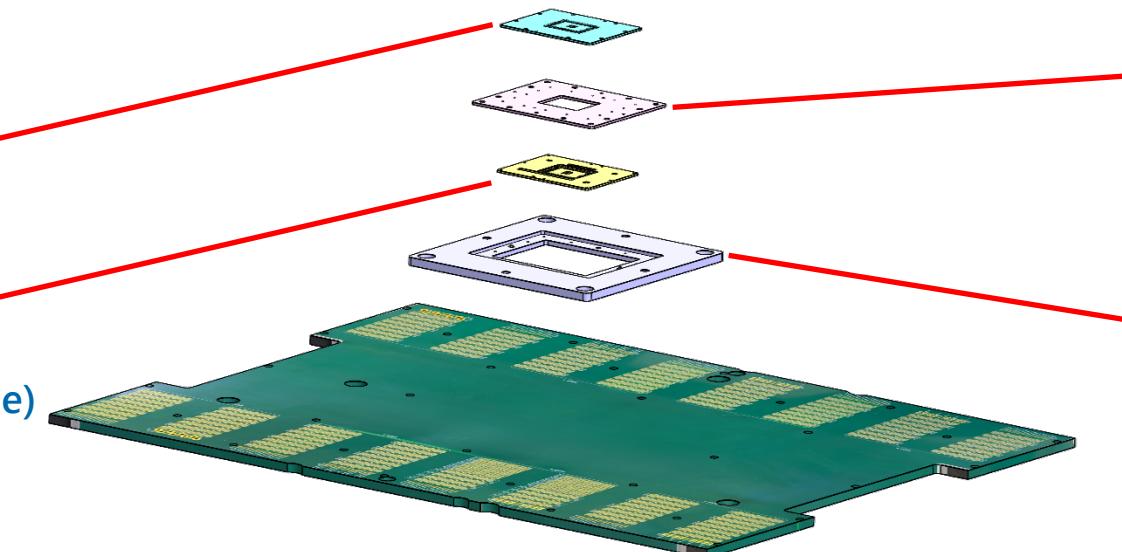
精密塑料 機械鑽孔  
Socket Plate



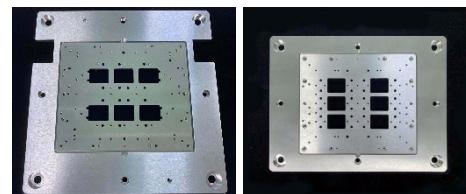
陶瓷微鑽孔  
UD (Upper Die)



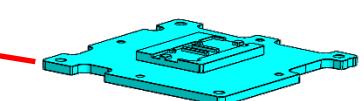
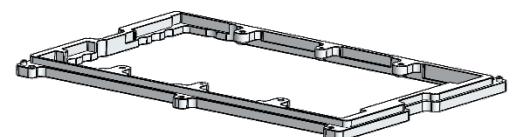
後支撐結構頂塊  
Push base  
後支撐結構板  
Backer



PH 乘載座(SUS420)  
Jig



測試機機框  
ATE stiffener  
93K-DD stiffener



結構補強框  
(AL or SUS420)  
Tester side support

# 未來五年台積電先進製程產能布建 近八成仍在台灣



## 2025~2030年積電先進製程產能布局狀況

業者	投資地點	廠區	製程	規劃月產能 (千片/12吋)	量產時點
台積電	台灣	新竹	Fab 20 P1, P2	N2/A16	100~120
			Fab 20 P3, P4	A14	4Q25 2028年
	高雄		Fab 22 P1, P2, P3	N2/A16	120~150
			Fab 22 P4, P5	N2/A16	4Q25~2027 2028年起
	台中		Fab 22 P6	A14	新案評估中
			Fab 25 P1~P4	A14/A10	待定 100~120 2028年起
	美國	亞利桑那州	Fab 21 P1	N4	4Q24
			Fab 21 P2	N3/N2	2027/2028年
			Fab 21 P3	N2/A16	2029~2030年
			Fab 21 P4	N2/A16	待定
			Fab 21 P5、P6	A14/A10	待定
日本	熊本		Fab 23 P2	N6	50 2027→2028年

資料來源：台積電 DIGITIMES整理 202511

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



# Q&A



7899.TW

# thanks

**景美科技 (CMAT)**

**全球信賴的半導體測試介面核心專家**

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造